

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-12-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	海通证券 肖隽翀；东方红 张子豪
时间	2023年12月14日（星期四）
地点	上海浦东嘉里大酒店
上市公司接待人姓名	副总经理/董事会秘书 李志萍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司情况介绍</p> <p>浙江中晶科技股份有限公司（股票代码：中晶科技003026.SZ）是一家专业从事半导体单晶硅材料及其制品研发、生产和销售的国家高新技术企业，是全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，是中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会会员单位，公司拥有宁夏中晶、西安中晶、中晶新材料全资子公司及江苏皋鑫控股子公司。</p> <p>公司拥有先进的具备自主知识产权的核心技术和工艺，配备优良的生产、检测设备和管理系统，以国际一流半导体企业为标准，致力于高品质半导体单晶硅材料及其制品的研发和生产。公司在半导体用单晶硅棒、研磨硅片、高压整流器件三个细分产业具有市场领先地位，形成以研磨硅片、抛光硅片、芯片元件为核心业务的三大产业板块，积极成为世界先进的半导体硅材料专业制造商而努力奋斗。</p> <p>二、互动交流</p>

1、请问公司产品下游应用领域目前有何拓展？

您好！公司目前的主要产品为半导体硅材料及其制品，产品涵盖半导体晶棒、研磨片、化腐片、抛光片、半导体功率芯片及器件等。公司半导体单晶硅片产品是制造半导体芯片的重要基础材料，是支撑半导体产业发展最重要、应用最广泛的基础功能性材料，主要应用于各类功率二极管、功率晶体管、大功率整流器、晶闸管、过压/过流保护器件等功率半导体器件，以及部分传感器、光电子器件、肖特基、FRD、MOS 器件的制造。公司的半导体功率芯片及器件作为各类电子设备的关键零部件，广泛应用于微波炉、激光打印机、复印机、CRT/TV 显示器、X 光机及大型医疗设备等领域。公司具有从晶棒到器件芯片产业链制造模式，不断为客户提供高品质、高效率、全规格的产品服务，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。谢谢。

2、公司核心竞争力有哪些？

您好！公司长期专注半导体硅材料及其制品的研发、生产和销售，公司的核心竞争力主要体现在：

（1）技术研发优势：公司自主掌握了磁控直拉法（MCZ）拉晶技术、再投料直拉技术等多项半导体硅材料制造加工的核心技术，同时拥有高频高压二极管研发和制造等多项功率器件用芯片制造核心技术。

（2）质量管理优势：公司建立了严格完善的生产质量管理体系，并贯彻执行“6S”现场管理以及生产精益化管理，从生产经营各环节对产品质量层层把控。

（3）成本控制优势：公司较强的技术研发实力不仅保证了产品质量的可靠性和稳定性，也降低了产品的生产成本，提高公司的盈利能力。

（4）客户及品牌优势：通过多年的市场积累与开拓，公司已在国内分立器件用单晶硅棒、研磨硅片，以及半导体功率芯片

及器件领域占据领先的市场地位，在行业内拥有良好的口碑，客户粘性强，市场认可度较高。

(5) 人才管理优势：公司核心管理团队均具有丰富的半导体行业从业经验及管理经验，在公司高质量、可持续发展方面起到了良好的引领作用。谢谢。

3、公司今年生产情况如何？

您好！公司目前具备较好的生产能力及货物交付能力，后续公司将结合实际经营情况，根据市场需求等情况有序规划、统筹安排，持续推进公司高质量发展。谢谢。

4、公司后续在融资和投资并购上有什么计划？

您好！公司未来将会在巩固现有行业地位的前提下，根据行业发展趋势和客户需求，密切关注与半导体材料行业相关的合作契机。谢谢。

5、公司未来发展布局是怎样的？

您好！公司作为国家高新技术企业，始终致力于高品质半导体单晶硅材料及其制品的研发、生产和销售。经过多年的技术研发和市场拓展，公司在半导体用单晶硅棒、研磨硅片、高压整流器件三个细分产业具有市场领先地位，形成以研磨硅片、抛光硅片、芯片元件为核心业务的三大产业板块：

(1) 研磨硅片：公司的主营业务为3—6英寸研磨硅片产品及其制品，未来将会持续发展，满足客户增量需求；

(2) 抛光硅片：公司募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》6-8英寸抛光硅片当前部分规格产品处于客户批量认证及上量的过程中；

(3) 芯片元件：控股子公司江苏皋鑫承接南通皋鑫的资产及业务，在高压整流器件细分领域占市场领先地位，以江苏皋鑫

为实施主体的《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》新厂房建设正式开工，随着项目推进，未来企业将迎来新的发展阶段。谢谢。

6、公司募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》后续产能释放如何计划？

您好！募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》以中晶新材料为实施主体，抛光硅片产品将会成为公司未来重要主营产品之一，当前部分规格的抛光硅片处于客户批量认证及上量的过程中。募投项目从投产到达产需要一定的周期，公司将结合实际经营情况，根据现有产能、市场需求等情况有序规划、统筹安排，持续推进募投项目的产能释放。谢谢。

7、请介绍一下江苏皋鑫《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》目前项目进展如何？

您好！2023年8月，江苏皋鑫《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》新厂房建设正式开工，随着项目推进，未来企业将迎来新的发展阶段。江苏皋鑫拥有国际先进水平的塑封高压二极管制造技术，具有行业领先的产品设计和产品应用技术的研发能力。未来，公司将持续加大研发投入和新产品导入，并积极推动项目建设投产，将江苏皋鑫建设成为优秀的半导体芯片研发和生产基地。谢谢。

8、请问贵公司的人员管理情况如何？如何提高员工的凝聚力以及公司认同感？

您好！公司充分重视人才培养和团队建设工作，通过合理的薪酬激励和岗位设置、定期组织员工培训等多形式培养了一批业务扎实、爱岗敬业的管理团队和人才队伍。同时为进一步

	推动企业人才结构的提升，增加企业的竞争力与创新能力，公司加大培育和引进行业高端人才、专业技术人才，为公司持续自主研发和创新提供重要的基础。谢谢。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 12 月 14 日